

# 2024 JIEPワークショップ 開催案内

日本半導体産業復権を支える実装技術  
 ~部品・材料・装置・プロセス 日本の強みを探求!~

招待講演、ナイトセッション講演、ポスター発表 50件 決定!

発表者と徹底議論 一般参加者大募集!

2024年10月10日(木)~11日(金)  
 ラフォーレ修善寺 サンパティックホール

本音トーク  
 Face-to-Face Give & Take

本音で議論できる様々なしかけ...フォーマルな場では聞けない情報が手に入る!  
 事業アイデアやビジネスパートナー探し、異業種人脈構築など活用は皆さん次第!

■ 招待講演

『世界をリードする日本の部品技術』

梶田 栄 様 (NPOサーキットネットワーク)

■ ナイトセッション・特別展示

『装着型サイボーグHAL®の活用法』

安永 好宏 様 (CYBERDYNE株式会社)

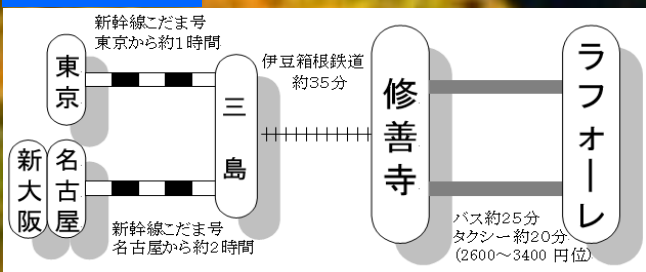
■ ポスター発表 (50件)

実装材料、装置、プロセス、パワエレ・カーエレ、  
 信頼性、分析、AI、センシング分野から厳選



アクセス

2024ワークショップ実行委員会 委員長 渡辺 尚徳 (東芝)



スケジュール(予定)

10月10日(木)		10月11日(金)	
13:00~	登録開始	07:30~08:30	朝食
13:30~13:45	オリエンテーション	09:00~	2日目セッション開始
13:50~15:00	第1セッション (アブストラクトトーク)	09:30~10:40	第3セッション (アブストラクトトーク)
15:10~17:20	第1セッション (ポスター)	10:40~11:40	第3セッション (ポスター前半)
18:00~19:40	夕食 (立食形式懇親会)	11:40~12:40	昼食
20:00~21:00	ナイトセッション講演	12:40~13:40	第3セッション (ポスター後半)
21:00~	第2セッション (自由討論)	13:50~15:00	招待講演
	就寝	15:10~15:25	アンケート・閉会式・現地解散

■ 招待講演 『世界をリードする日本の部品技術』  
梶田 栄/サーキットネットワーク

■ ポスターセッション

10月10日(木) 15:00 - 17:00 (第1セッション)		10月11日(金) 10:10 - 13:40 (第3セッション)	
実装材料・部品技術	1. 大型・高密度配線・高信頼性を有する 高性能半導体用インターポーザ 有吉 絢子/大日本印刷	パワエレ・カーエレ	26. パワー半導体におけるワイヤ接合部の樹脂補強技術 -パワーサイクル寿命の向上！補強樹脂の選定- 南 尚吾/東芝
	2. RF向けガラス配線基板と個片化技術の開発 澤田石 将士/TOPPANホールディングス		27. パワー半導体におけるワイヤ接合部の樹脂補強技術 -補強樹脂の硬化プロセス適正化- 千島 祐也/東芝
	3. 曲げによる導電性接着剤の抵抗上昇抑制のためのセルロースナノファイバー添加とその可視化 北本 菜々花/大阪大学		28. パワー半導体向け銅接合材と低加圧接合プロセスの開発 濱西 恭良/石原ケミカル
	4. Sn-Ag-Cu 系および Sn-Bi 系 solderペーストのフィレット形成に及ぼすセルロースナノファイバー添加の影響 大熊 章/松尾ハンダ	実装材料・部品技術	29. 伝熱方向の制御を可能にする高熱伝導グラファイトを用いたヒートスプレッドの開発 竹馬 克洋/サーモグラフィティクス
	5. PTFEと低CTEポリイミドフィルムの直接接着および低伝送損失基板の開発 土屋 俊之/東洋紡		30. バンプレス接合によるWafer-On-Wafer積層用樹脂の開発 新木 直子/ダイセル
	6. 低誘電ポリイミド樹脂の半導体後工程への応用 中村 太陽/荒川化学工業		31. Cu-Cuハイブリッド接合用新規接着材料による積層プロセス検証 早川 諒/三井化学
3D・光・最先端PKG	7. 低誘電特性フィルムの開発 (仮) 内田 充哉/太陽インキ製造	プロセス・接合技術・装置	32. 還元処理を用いたGe/Diamond基板の複合化 箕輪 裕樹/東京理科大学
	8. 無粗化で高密着な樹脂めっきプロセスによる三次元配線形成技術 目黒 和幸/若手県工業技術センター		33. Φ300mm_COWにおける新しい反り制御技術 (FEM解析) について 土井 渉/村田製作所
	9. 2.5D/3Dチップレット アドバンスドパッケージソリューションへのアプローチ 久保田 匡/TOWA		34. ニセモノ排除へ！新規真贋判定プロセスの提案 高野 健/リンテック
パワエレ・カーエレ	10. 高速スイッチングをめざしたGaN-HEMTデバイス搭載のパワーモジュール実装検討 杉木 昭雄/大分デバイステクノロジー	プロセス・接合技術・装置	35. インプリントプロセスにおける銀ペーストの転写性 小松 裕司/コネクテックジャパン
	11. パワー半導体デバイス向け高耐熱実装技術の研究 小柴 佳子/神奈川産総研		36. インプリントとフォトリソ工法の融合による10μmピッチ先鋭マイクロバンプの形成 武知 佑輔/パナソニックホールディングス
プロセス・接合技術・装置	12. 企業連携プロジェクト“JOINT2”における先端半導体パッケージング技術 姜 東哲/レゾナック	プロセス・接合技術・装置	37. 次世代向け高精度W2W接合技術の開発 ~歪補正への取り組み~ 神林 正弘/ニコン
	13. H <sub>2</sub> O インサートによるアルミニウム合金の低電力抵抗溶接 小山 真司/群馬大学		38. 自己組織化ハイブリッド接合によるHBM 積層手法の検討 杜 澤華/東北大学
	14. ダイレクトハイブリッド接合における界面特性評価 吉原 佑樹/横浜国立大学		39. マイクロLEDディスプレイ向け高速実装技術の開発 秦 章浩/東レエンジニアリング
	15. あらゆる素材の表面改質を提案!! 新しい機能性と価値の創造 (断熱 絶縁 防汚) 萬 隆行/日本パーカラライジング	信頼性評価・分析技術	40. 極小チップ対応高精度搭載装置等 上島 直人/アスリートFA
	16. Cu-Ni-Ti合金を用いたスパッタリングシード層の開発 小林 祐輝/新光電気工業		41. 2.xD向け低熱膨張基板の狭ピッチスルーホールの絶縁評価技術 垣谷 稔/レゾナック
	17. パワーデバイス後工程 3D寸法検査装置VT-M2A (チップ・ワイヤの全数検査を実現) 古川 達也/オムロン		42. "NanoTerasu (ナノテラス) とエレクトロニクス"という未来 高田 昌樹/東北大学
AI・機械学習	18. 半導体アドバンスドパッケージングを支える最新モールドング技術 齊藤 高志/アピックヤマダ	信頼性評価・分析技術	43. 投入エネルギーと基板延焼範囲の相関調査 佐藤 光希/日産自動車
	19. 直接イオン化質量分析と機械学習によるシリコン放熱材料の性能予測 伊藤 真紀/日立製作所		44. 温度環境下におけるプリント実装基板の3次元熱変形計測と各種評価解析への適用 萩 慶佑/エスベック
信頼性評価・分析技術	20. AIを活用した実装基板の信頼性予測 竹内 良/東芝	設計技術	45. ファンアウトウェハレベルパッケージに向けたデジタル画像関連法を用いた反り評価と応力計算法の検討 根本 俊介/神奈川産総研
	21. はんだクラック三次元解析 ~線膨張係数編~ 鬼塚 梨里/クオルテック		ウェアラブル・プリンタブル
IoT/センシング	22. ギリギリを見抜く熱履歴計測用回路チップの研究 岡本 有貴/産総研	IoT/センシング	
	23. 赤外線画像を活用したフローはんだ付けにおける 工程内不良抑制システムの開発 川添 徹也/三菱電機		48. 光計測による、蚕、ヘビ、ハクビシン、ヘビ、ウシ、ヒトの脈波の比較 野上 大史/崇城大学
IoT/センシング	24. 食事バランスを20秒でチェック！自宅で簡単に使える尿センサー 浅井 開/ファーストスクリーニング	IoT/センシング	49. 会いたくてふるえる「触覚フィルム」 竹井 裕介/産総研
	25. 身体に巻くだけで肺の状態が分かるストレッチャブル3D-EITヘルム 野村 健一/産総研		

申込: 下記よりお申し込みください。

一般参加の方はこちら

発表者はこちら

参加費用: 正会員・賛助会員: ¥ 45,000、シニア会員: ¥ 40,000、学生会員: ¥ 35,000、  
協賛会員: ¥ 50,000、一般: ¥ 55,000  
(資料代、宿泊費、食事、消費税を含みます。)  
\*なお一般の方は、同時に学会にご入会いただくと、初年度のみ年会費半額で、  
かつ今回のワークショップに会員扱いでご参加いただけます。

協賛団体: サーキットネットワーク(C-NET)、応用物理学会シリコンテクノロジー分科会、表面技術協会、  
よこはま高度実装技術コンソーシアム(YJC)、スマートプロセス学会 (予定)

申込締切: 9月13日(金) (ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。)

定員: 100名(先着申込順)

問合せ先: 〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2, Tel:03-5310-2010,  
Email: 2024ws@jiep.or.jp